

## Установка шлифовки и полировка пластин EVG-300

Установка шлифовки и полировка пластин EVG-300

### Цена:

Цена по запросу

### Описание

Установка шлифовки и полировки пластин EVG-300 обеспечивают обработку полупроводниковых пластин и подложек диаметром до 300 мм на основе таких материалов как кремний (Si), германий (Ge), карбид кремния (SiC), арсенид галлия (GaAs), нитрид галлия (GaN), нитрид алюминия (AlN), фосфид индия (InP), сапфир, керамика, стекло, титан, сталь. Загрузка подложек осуществляется оператором вручную, а процесс утонения автоматически согласно заданному рецепту. Помимо поштучной обработки, доступна возможность групповой обработки подложек, закреплённых на временном носителе диаметром до 300 мм. Установка EVG-300 оснащается специальными шлифовальными/полировальными дисками Engis на основе технологии MAD (Mixed Abrasive Diamond), которая адаптирует спецификацию диска к типу обрабатываемого материала для достижения оптимальной плоскостности, шероховатости и исключает необходимость использования дополнительного оборудования. Компактные габаритные размеры в сочетании с широкими функциональными возможностями установки шлифовки и полировки EVG-300 соответствуют современным требованиям мелкосерийного производства или научно-исследовательских лабораторий.

Возможны бесплатные тесты шлифовки и полировки в лаборатории производителя на образцах заказчика.

**Engis** Example #1: SiC wafer

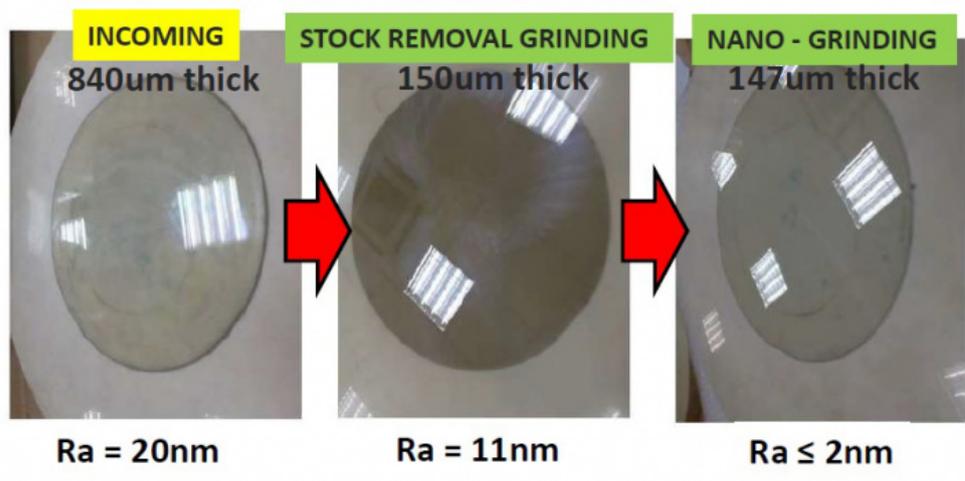
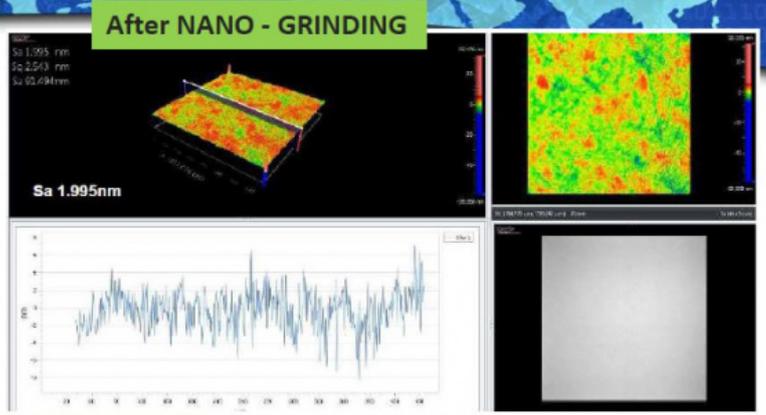


Рис.1. Пример утонения пластины SiC Ø100 мм с 840 мкм до 147 мкм с использованием шлифовальных/полировальных дисков Engis.